

# ニッケルレス最終表面処理プロセス

Final Surface Treatment Process Without Nickel Plating

銅上への無電解金めっきプロセス  
Electroless Gold Plating Process on Copper Circuit

銅上への無電解パラジウム/金めっきプロセス  
Electroless Palladium/Gold Plating Processes on Copper Circuit

## トップギルドプロセス

TOP GILD PROCESS

## トップパラスプロセス

TOP PALLAS PROCESS

### トップギルドプロセス

TOP GILD PROCESS

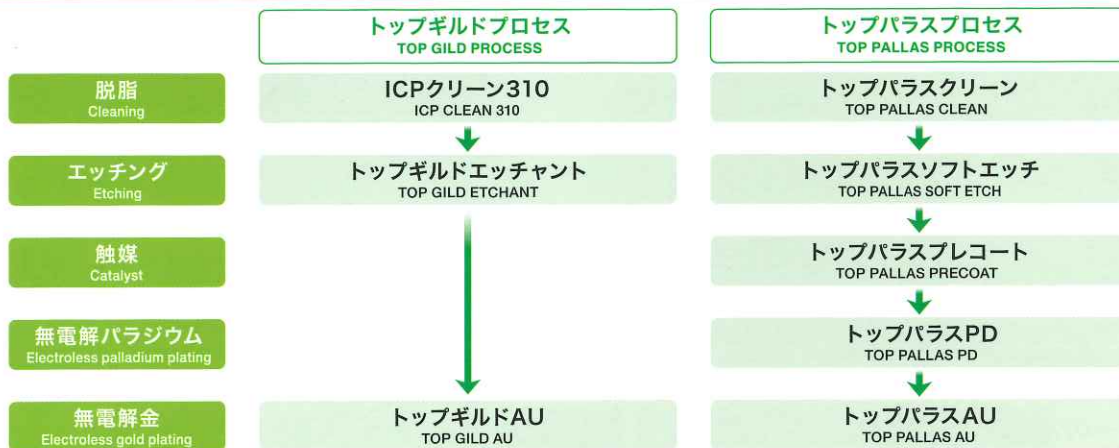
- 銅上への金析出性が良好
- ファインパターン性に優れる
- Roll to Roll仕様にも対応
- Good deposition ability of gold plating on copper substrate
- Excellent fine circuit pattern ability
- Suitable for Roll to Roll treatment

### トップパラスプロセス

TOP PALLAS PROCESS

- 銅上へのパラジウム析出性が良好
- はんだ接合性、金 ワイヤボンディング性に優れる
- 耐折性、耐食性が良好
- ファインパターン性に優れる
- Good deposition ability of palladium plating on copper substrate
- Excellent solder jointing ability and wire bonding ability of gold
- Good bendability and corrosion-resistance
- Excellent fine circuit pattern ability

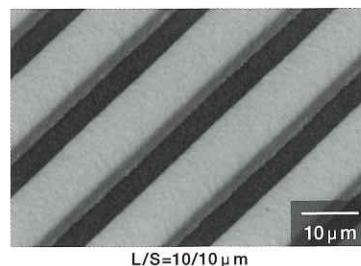
### 処理工程 Process



### トップギルドプロセス TOP GILD PROCESS

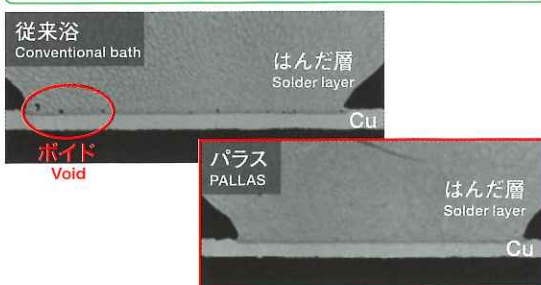


### ファインパターン性 Fine circuit pattern ability



### トップパラスプロセス TOP PALLAS PROCESS

#### はんだ接合時の断面 Cross-section as-solder jointed



#### MIT試験結果(折り曲げ試験) Results of MIT test (Bending test)

